

# PICOSUN™ P-300B

PICOSUN™ P-300B ALDシステムは、プリントヘッド、センサー、マイクなどのMEMSデバイスの生産、およびレンズ、光学系、機械部品、宝石、コイン、医療用インプラントなどの3D形状物の成膜に最適な装置です。



## 技術的特長

PICOSUN™ P-300B ALDシステムは、大量生産用ALDの新しい標準となっています。特許取得済みのホットウォール設計と完全に分離したプリカーサ注入口を組み合わせることにより、優れた歩留まり、低パーティクルレベル、優れた電気的および光学的性能を備えた最高品質のALD膜を作り出すことができます。簡単かつ迅速なメンテナンスを備えたアジャイルな設計により、システムのダウンタイムを最小限に抑え、市場での所有コストを最小限に抑えることができます。当社独自のPicoflow™ディフュージョンエンハンサ技術により、生産実績のあるプロセスで、超高アスペクト比の基板にも非常に付回りの良いコーティングができます。

PICOSUN™ P-300B ALDシステムは、MEMSおよび3D部品の生産におけるバッチ処理のための特別設計となっています。このシステムは高速で信頼性が高く、メンテナンスが非常に容易に行えます。

### 標準的な基板サイズと種類

- 200 mmウエハでバッチあたり25枚 (標準ピッチ)
- 150 mmウエハでバッチあたり50枚 (標準ピッチ)
- 100 mm ウエハでバッチあたり75枚 (標準ピッチ)
- 非ウエハ基板 (特注ホルダー)
- 高アスペクト比サンプル(1:2500~)

### 処理温度

- 50~500°C

### 標準プロセス

- 最小一桁秒のサイクルタイムでバッチ処理が可能\*
- $Al_2O_3$ 、 $TiO_2$ 、 $SiO_2$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $HfO_2$ 、 $ZnO$ 、 $ZrO_2$ 、 $TiN$ 、 $AlN$ 、およびメタル
- バッチ成膜の1 $\sigma$ 不均一性 < 1% ( $Al_2O_3$ 、面内・ウエハ間・バッチ間、49点測定、EE:5mm)\*\*

### 基板ローディング

- 空圧リフトによるマニュアルローディング
- リニアセミオートローディング
- 産業ロボットによるローディング

### プリカーサ

- 液体、固体、気体、オゾン
- レベルセンサ (オプション)
- 4カ所に分かれた注入口から最大8種のソース

\* サイクル時間 < 10秒

\*\* 面内不均一性 < 1%

詳細な情報をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

**picosun**  
AGILE ALD